

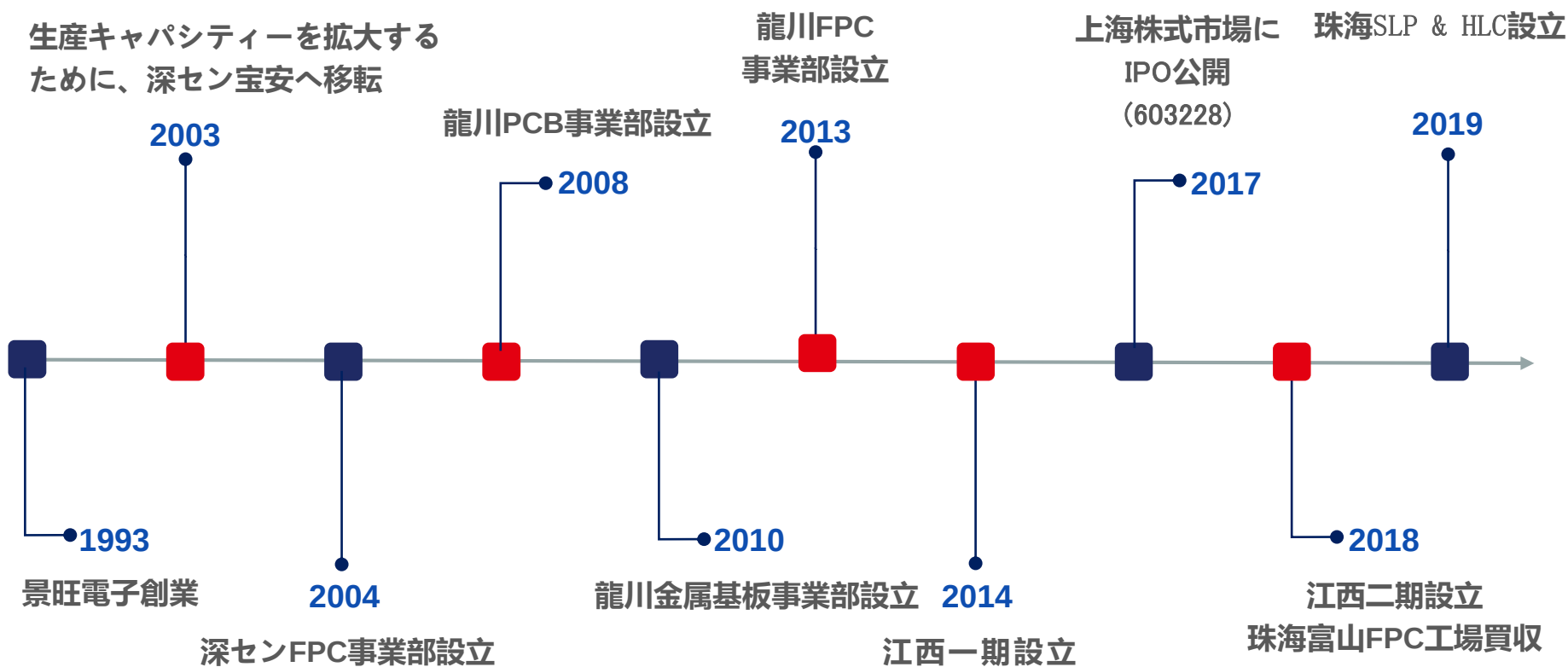
KINWONG

景旺电子

景旺電子

世界で最も信頼される
プリント配線板メーカーを目指す

株券コード：603228



27年プリント基板製造経験

1993年~2020年

社員
人数: 12000+

売上高

2019年売上高: USD972M

2020年売上高目標: USD1,091M

4つ生産基地

SZ広東深セン LC広東龍川
JX江西吉安 ZH広東珠海

3週類の製品

PCB

フレキシブル基板PCB (FPC)
金属基板PCB(MPCB)

中央実験室

- 2006年生産開始
- 330+特許取得
- ISO17025/CNAS認証取得

深セン本部

生産基地

SZ 広東深セン
LC 広東龍川
JX 江西吉安
ZH 広東珠海
(富山, 高栏港)

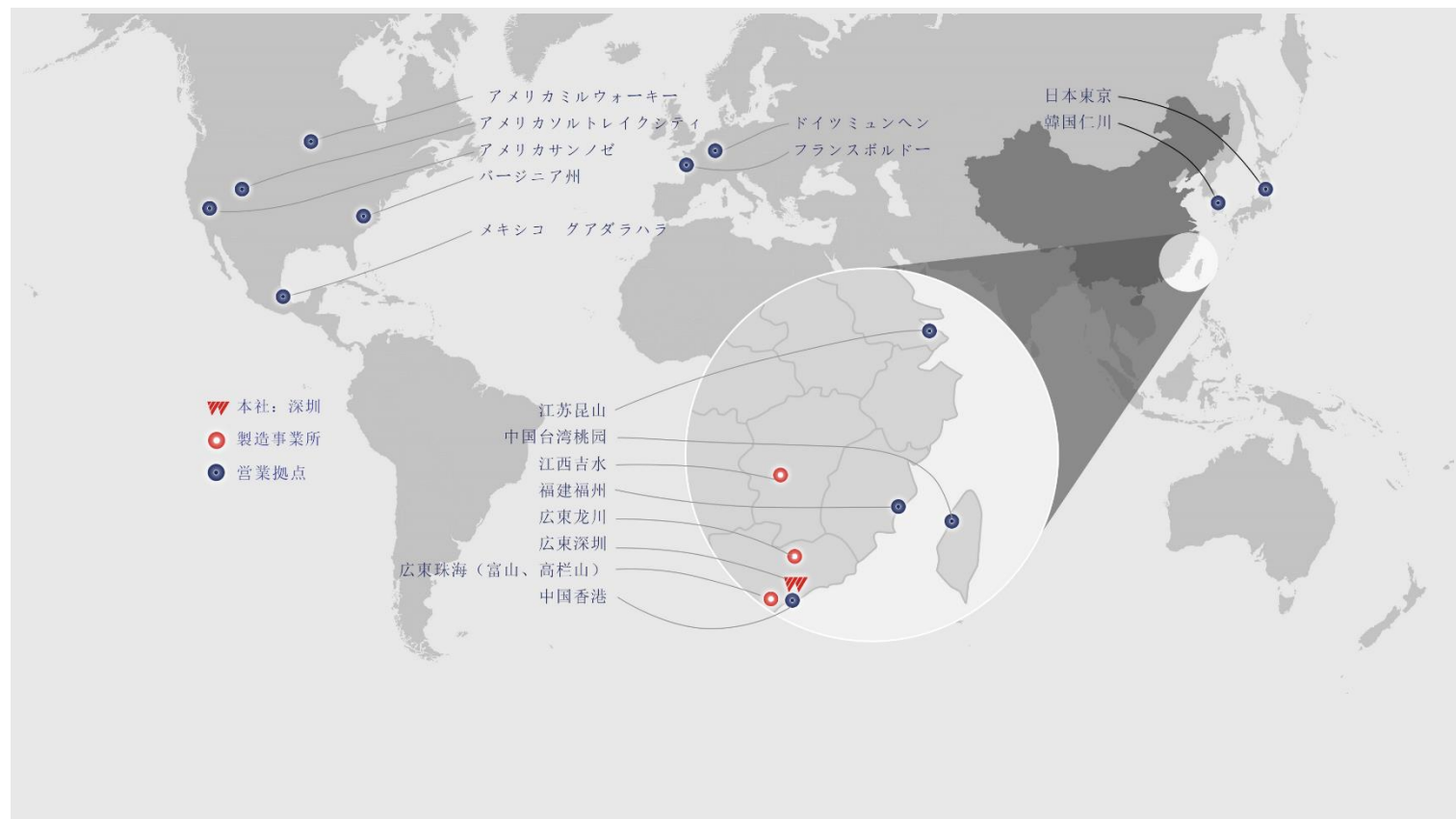
営業拠点

HK 香港
KS 江苏昆山
FZ 福建福州
TW 台湾桃園
EA 韓国仁川

FAE&BD

EA 日本東京
EU ドイツミュンヘン
EU フランスボルドー
NA USソルトレイクシティ
NA USミルウォーキー
NA USサンノゼ
NA USバージニア
NA メキシコグアダラハラ

パターンは世界を繋ぎあらゆるものを構築する



四つ生産基地ロケーション

KINWONG

江西基地

1. 深セン基地まで630km、8時間かかる
2. Jinggangshan空港まで76km、1時間かかる

江西吉安



珠海基地

1. 富山工場：深セン基地まで170km、5時間かかる
2. 高栏港工場：深セン基地まで192km、2時間50分かかる



珠海富山



珠海高栏港

江西

龍川

深セン
珠海

龍川基地

深セン基地まで290km、4時間かかる

広東龍川

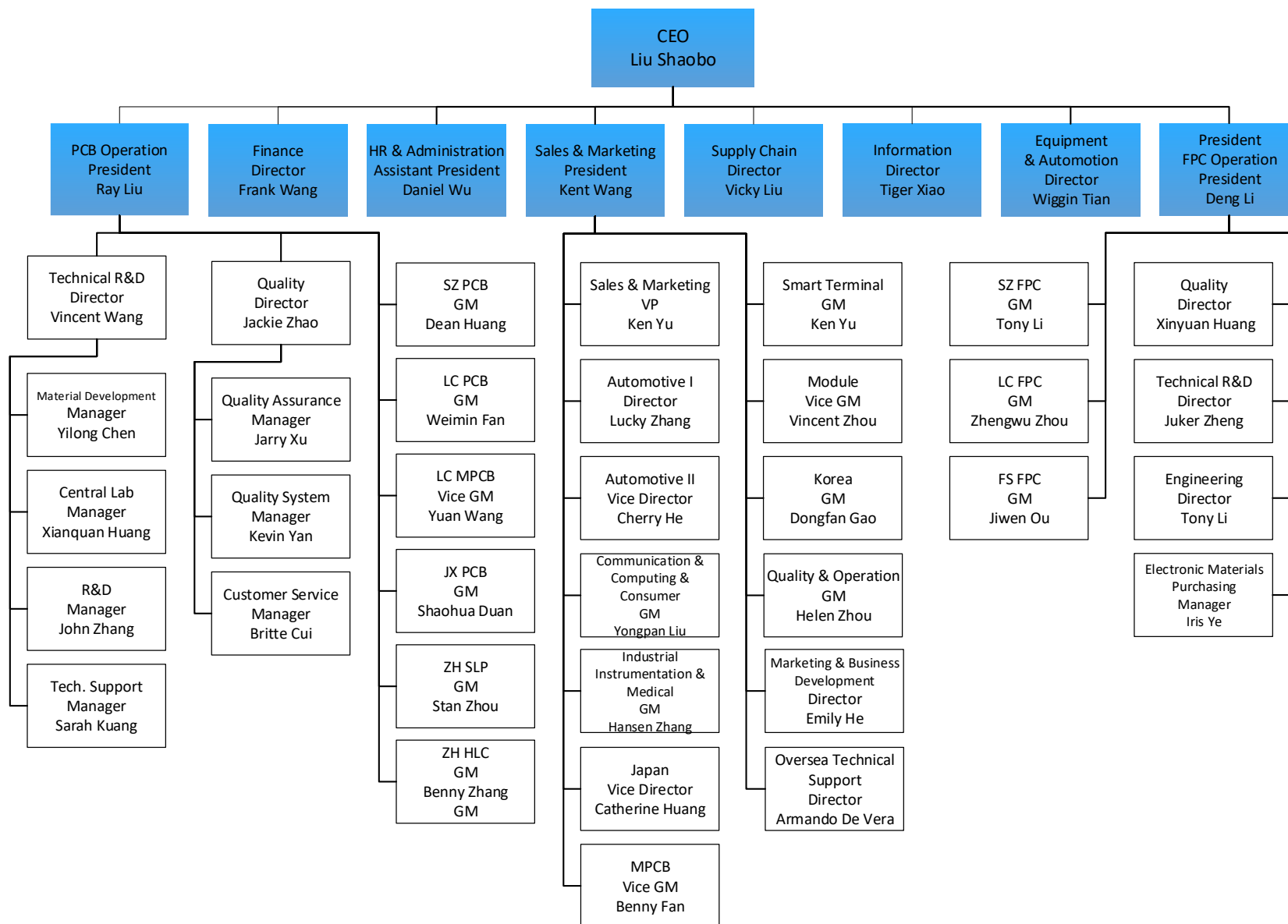


深セン基地

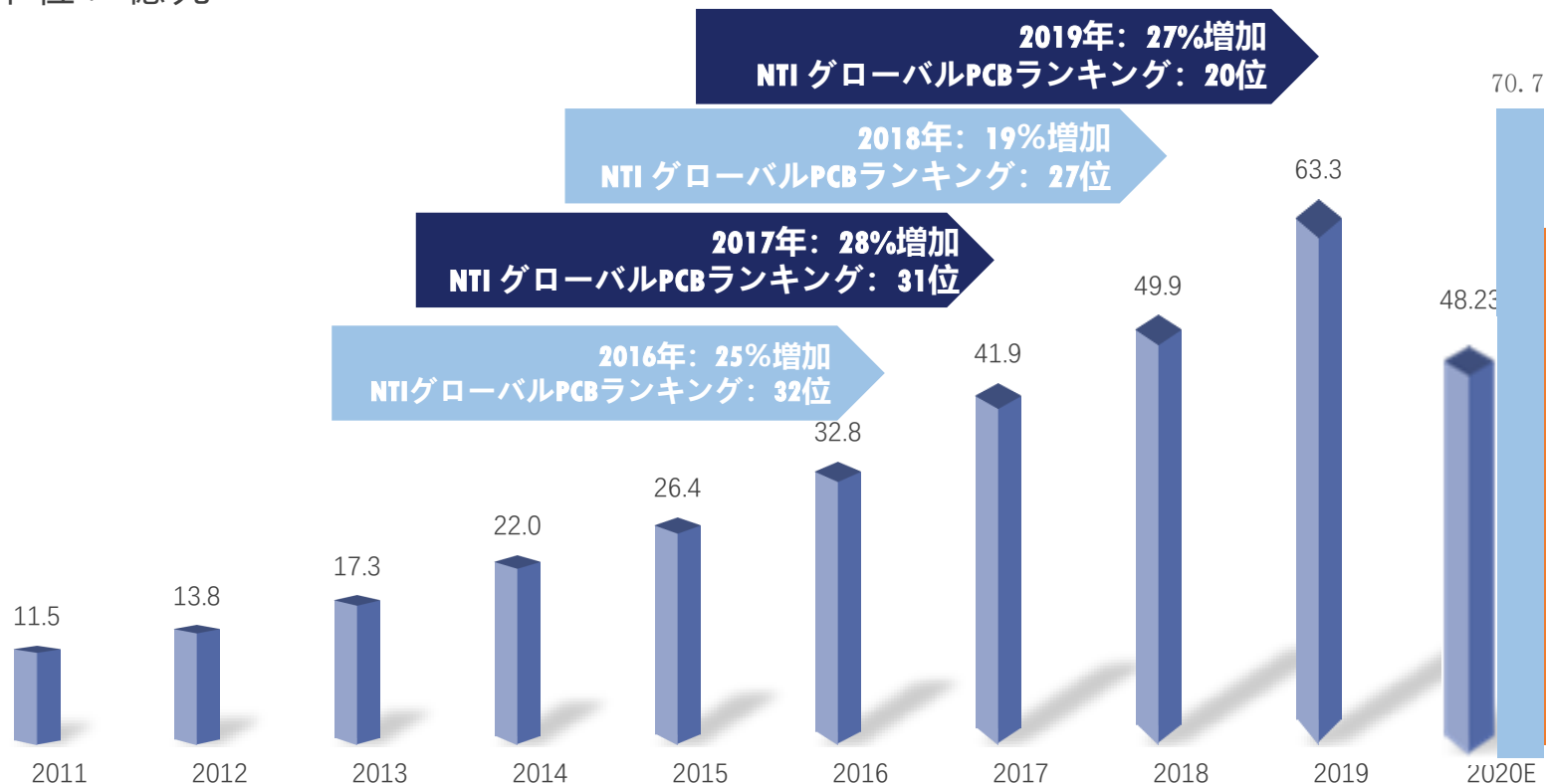
1. 深セン空港まで18km、20分かかる
2. HK空港まで70km、2時間かかる



広東深セン



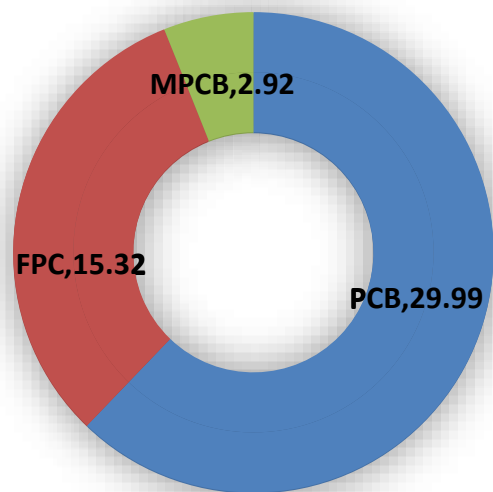
単位：億円



* 10年連続の年度に比べ伸び率は20%以上で、着実な売上増加は安定的な品質・競争力あるの価格・より良いサービスに依存します。

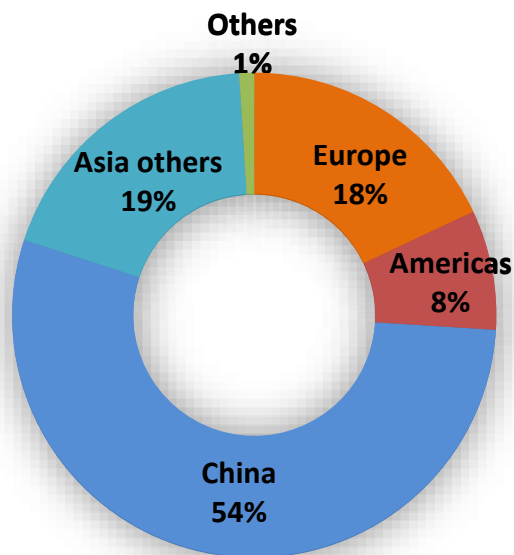
備考：売上高はプリント基板関連収入のみで、他の収入(約1億円)を含まない。

2020年Q1 ~ Q3
売上高48.23億円



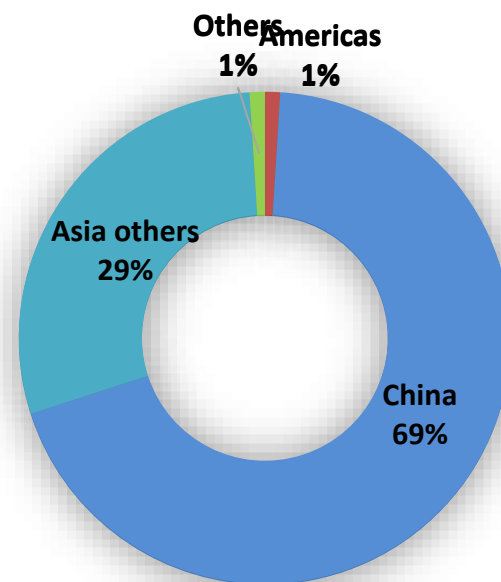
■ PCB ■ FPC ■ MPCB

2020年Q1 ~ Q3
PCBエリア別売上比率



■ Europe ■ Americas ■ China ■ Asia others ■ Others

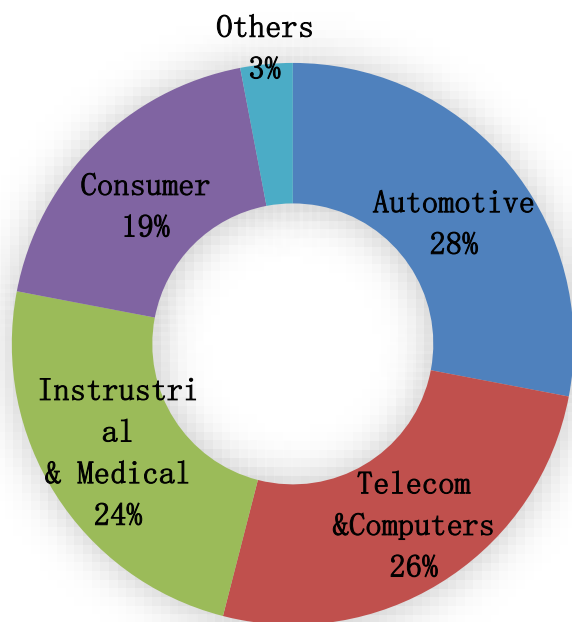
2020年Q1 ~ Q3
FPCエリア別売上比率



■ Americas ■ China

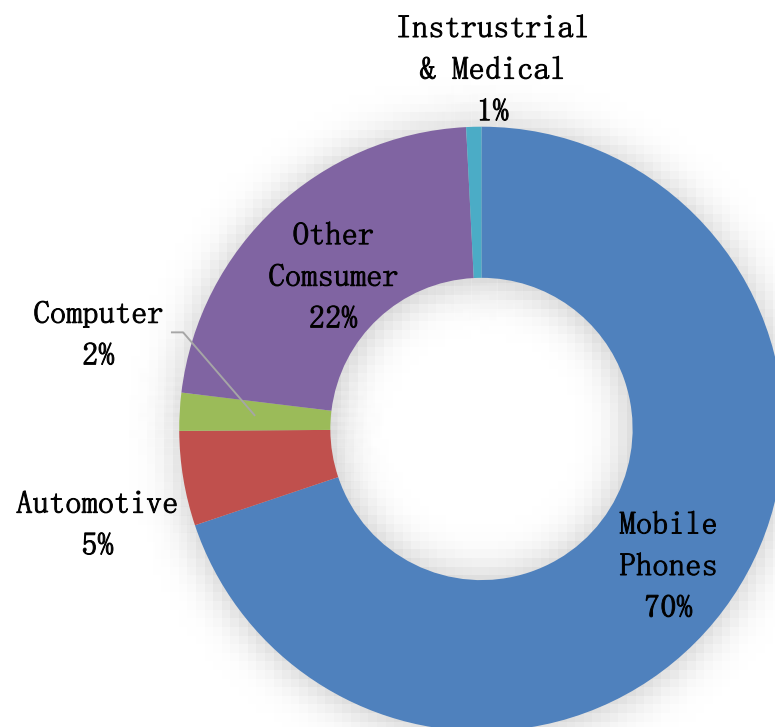
備考：売上高はプリント基板関連収入のみで、他の収入(約1億円)を含まない。

2019年PCB应用分野比率



■ Automotive ■ Telecom ■ Industrial & Medical ■ Consumer ■ Others

2019年FPC应用分野比率



■ Mobile Phones ■ Automotive ■ Computer ■ Other Consumer ■ Industrial & Medical

4 生産基地の概要(SZ, LC, JX, ZH)



工場敷地



50,000 m²

F1

深セン基地

- 本社
- PCB 事業部 & FPC 事業部
- 月生産キャパ: PCB**63,000**m², FPC**25,000**m²
- 社員: **2,000+**



230,000 m²

F2

龍川基地

- 子会社: 中国広東省河源龍川.
- 生産品目: PCB, FPC, MPCB
- 月生産キャパ: PCB**100,000**m², FPCB **80,000**m², MPCB**40,000**m²
- 社員: **3,580+**



240,000 m²

F3

江西基地

- 子会社: 中国江西省吉安
- 江西PCB部門: 世界をリードする最先端の知能PCB工場
- 月生産キャパ: **290,000**m² in 2019、**390,000**m² in 2020
- 社員: **2500+**



85,000 m²

F4-1

珠海基地

富山工場

- 子会社: 中国広東省珠海
- 富山 FPC 部門
- 月生産キャパ: **40,000**m² FPC
- 社員: **1200**



150,000 m²

F4-2

高栏港工場

- 子会社: 中国広東省珠海
- 高多層HLCとSLP工場は2019年に着工し、2021年頭に生産開始予定
- 月生産キャパ (計画) : **100,000**m² PCB (高多層), **50,000**m² SLP

4 生産基地の製品種類

KINWONG

拠点	事業部	月生産 キャップ	リ ジ ット 基 板	フ レ キ 基 板	金 属 基 板	リ ジ ット フ レ キ	ビルド アップ	高多層 基板	高周波	バス バー 基 板	モジュール/ サブスト レート /SIP	フ レ キ + SMT	工場特色
深圳	PCB	63,000㎡	✓			✓	✓	✓	✓				小ロット多品種、特殊材料、特殊技術、リジットフレキ、高周波高速、高多層厚銅、ビルドアップ 応用分野: 車載、通信、工業、電源、医療など
	FPC	FPC: 25,000㎡ FPCA: 10KK		✓		✓						✓	小ロット～中ロット 応用分野: 通信モジュール、タッチパネル、車載、工業、ドローン、電子タバコ、スマートホーム、医療など
劉川	PCB	100,000㎡	✓					✓	✓				中ロット～大ロット多層基板 応用分野: 通信、電源、車載、工業など
	FPC	FPC: 80,000㎡ FPCA: 60KK		✓		✓						✓	中ロット～大ロット 応用分野: 車載、表示モジュール、スマートフォン、LEDバックライト、電子タバコ、TWSなど
	MPCB	40,000㎡			✓					✓			中ロット～大ロット、放熱解決案の提供に専門する 応用分野: 新エネルギー車、車載照明、電源モジュール、照明など
江西	PCB	390,000㎡	✓						✓				大ロット 応用分野: 車載、消耗品、通信など
珠海	富山FPC	FPC: 50,000㎡ FPCA: 40KK		✓		✓						✓	大ロット、 応用分野: 医療、無線充電、タッチパネル、車載、TWS、スマートホーム、モジュール、5G関連など
	高欄港HLC	100,000㎡					✓	✓	✓				大ロット、高多層基板、 応用分野: 通信、ネット関連、サーバー、メモリー。車載など
	高栏港SLP	50,000㎡					✓				✓		大ロット・SLPライン、 応用分野: 通信、コンシューマーなど

なぜ景旺を選びますか



景旺の核心的価値観

堅実な財務管理

リアルタイムのローカル
技術と品質サービス

大手企業のお客様から
何回も受賞する

製品タイプ: PCB、FPCB、
PCB+FPCB複合基板、
MPCB、SLPと高多層基板



技術力とロードマップ

✓ 大電力・大電圧・大電流 ● 放熱管理ソリューション

IMS銅/アルミ金属基板

銅突出付き | 高伝熱係数
良い放熱性能 | 高電気性能

厚銅基板

低熱応力 | 厚銅6oz UL認証

嵌銅/氮化铝板

“I”, “T”, “U”形銅コア | 平面度Max. $\pm 30\mu\text{m}$



電動化



補助運転/自動運転

高スピード伝送率 ● 低損失

高周波ミリ波レーダ

炭化水素/PTFE系列基材

混圧 | バイアホール

パターン精度 ($\pm 15\mu\text{m}$)

多高層位置決め精度 ($\pm 5\text{mil}$)

HDI

2+N+2

0.65mm BGA Pitch (2021珠海工場生産能力もつ

と高い)

60 μm /60 μm L/S

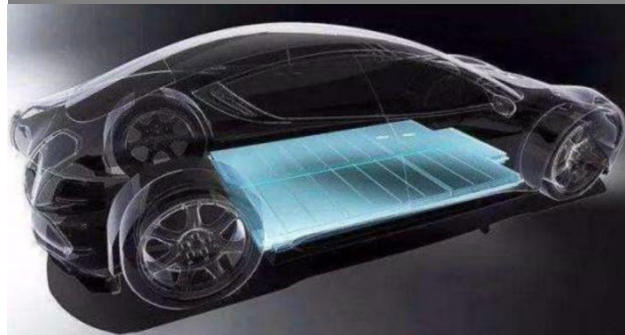


大型ディスプレイFPC

機能豊富●長時間持続

- 金端子広いPITCH (>100mm)
- 無電解金メッキ表面処理
- 機械ドリル最小0.1mm, レーザードリル最小 0.05mm
- 最小L/S: 45um/45um
- インピーダンス管理

バッテリー管理システム FPC



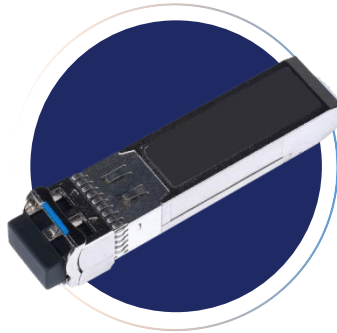
高耐熱性●ハイパワー

- FPC 長さ>1000mm
- 銅厚> 2 OZ
- 3 D補強アセンブリ
- 部品を接着剤で保護する



高速 ● 高伝送スピード ● 低損失

多高層基板
大きなサイズ
ミニホールバックドリル
パッド オン フィールドビア
Skip Via
抵抗管理
挿入損失



光モジュール
無電解金メッキ/
ニッケルパラジウム金メッキ
+金端子
高速材料
混圧
HDI
N+N
階段設計
銅インレイ
格付け/分段金端子
厳しいサイズ公差

アンテナ
2L~4L
高周波材料
混圧
階段設計
高周波回路公差



TRX/アンプ/ベースバンド/
バック基板
大きいサイズ
バックドリル
POFV
半穴設計
端面メッキ



- 高密度
- ミニビアサイズ
- ハイ キャパシティー
- 軽い、薄い及びミニ



HDI

- ▶ 3+N+3
- ▶ エニレーヤ (2021珠海)
- ▶ SLP (2021珠海)
- ▶ mSAP (2023珠海)
- ▶ amSAP (2023珠海)
- ▶ 最小L/S 30um/30umL/S
- ▶ スタック ビア/位置ズレビア/ステップ ビア
- ▶ 最小基板厚さ0.2mm

5G スマートフォン



5G アンテナFPC

5GランスミッションラインFPC

- ▶ PTFE/LCP/MPI材料
- ▶ 3L~4L
- ▶ レーザー プラインドホール
- ▶ プラインド穴埋め
- ▶ インピーダンスコントロール
- ▶ インサートロースコントロール
- ▶ 信号シミュレーション
- ▶ 3D SUS強化補充

ドローン



ドローン FPC

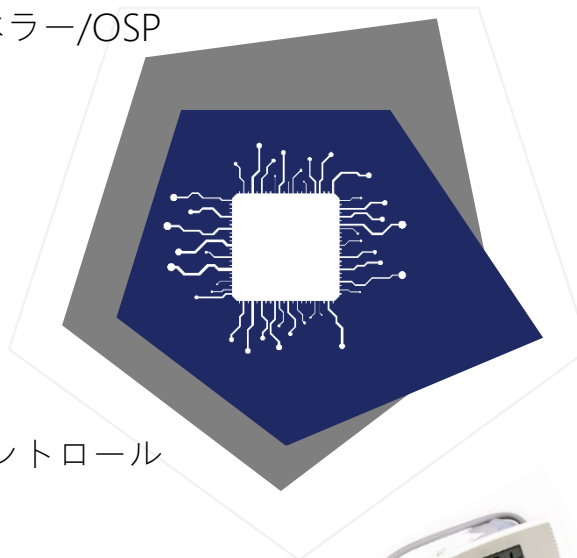
- ▶ L1~6L
- ▶ 最小ドリル0.1mm
- ▶ 最小レーザー プラインドホール0.05mm
- ▶ 最小L/S : 45um/45um
- ▶ 無電解金メッキ/ニッケルパラジウム/水溶性プリフラックス
- ▶ インピーダンスコントロール
- ▶ 3D SUS強化補充



長い信頼性・高安定性

リジッドフレキ

- ▶ 無電解金メッキ/半田レベラー/OSP
- ▶ Max 16L
- ▶ Max 6Lフレキ
- ▶ 曲げ部層違い
- ▶ リジッド部膜カバー
- ▶ HDI
- ▶ 金端子設計
- ▶ ディスペンシング
- ▶ $\pm 10\%$ インピーダンスコントロール



セミフレキ

- ▶ Max 2L曲げ可能
- ▶ 曲げ部厚さ $0.25\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$
- ▶ 曲げ角度 $0 \sim 180^\circ$



ポータブル・小型化・インテリジェント化

リジッドフレキ

- ▶ 曲げ可・ミニサイズ 3D組立
- ▶ 中/高Tg基材
- ▶ レジスト穴埋め



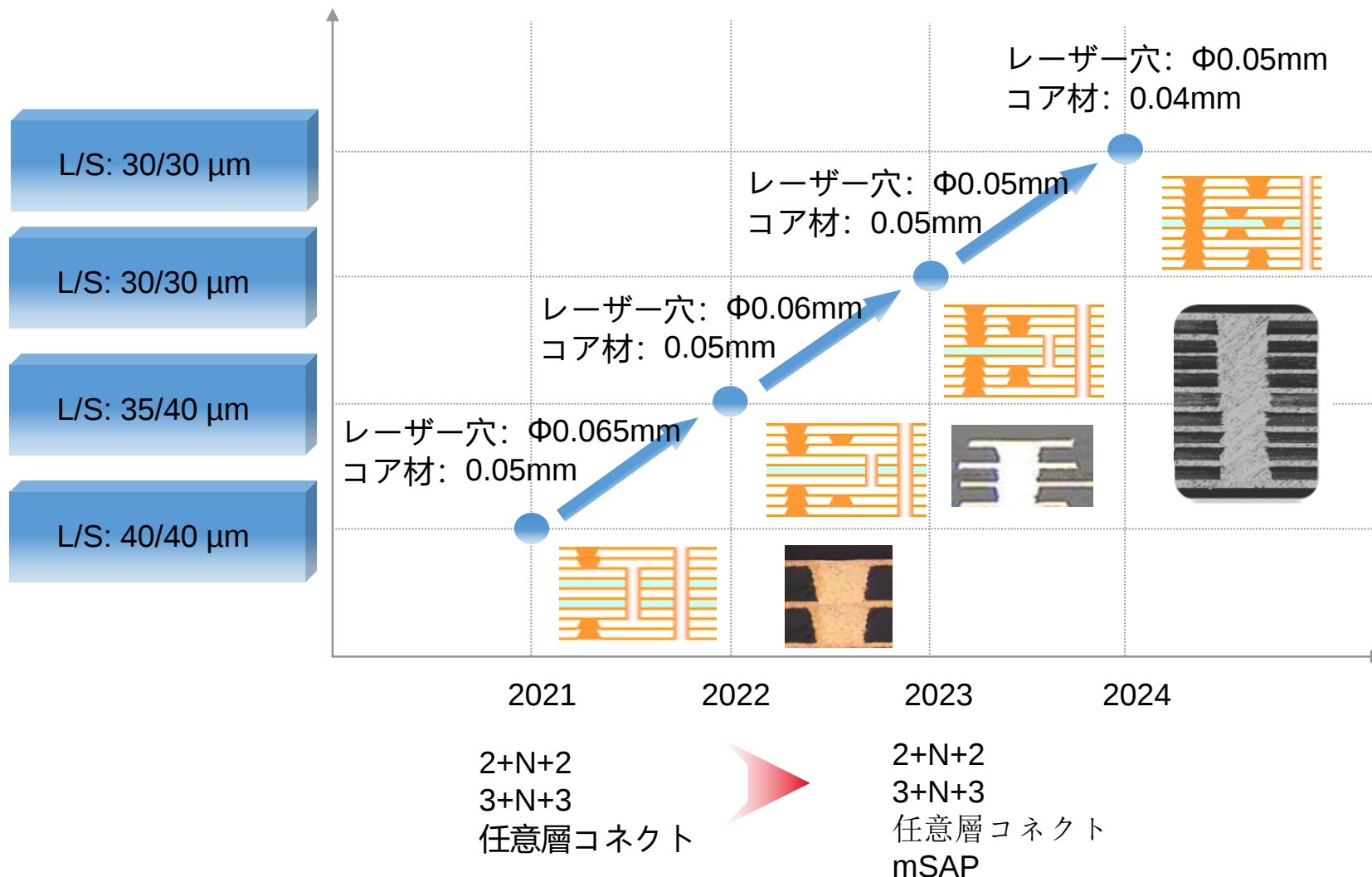
項目	2020	2021	2022
最高層数	18L	24L	32L
最大デリバリパネル	594*699mm	620*950mm	620*950mm
最薄コア材厚	0.075mm	0.05mm	0.05mm
板厚	0.4~3.6mm	0.4~4.5mm	0.4~5.0mm
最小内層L/S	0.076mm/0.076mm	0.06mm/0.06mm	0.06mm/0.06mm
最小外層L/S	0.076mm/0.076mm	0.065mm/0.076mm	0.065mm/0.076mm
最小ドリル径	0.2mm	0.15mm	0.15mm
最小レーザー径	0.1mm	0.1mm	0.1mm
最大スルホール縦横比	12:1	18:1	20:1
最大レーザー縦横比	0.8:1	1:1	1:1
HDI	3+N+3	3+N+3	3+N+3
レジスト位置セット精度	+/-0.05mm	+/-0.040mm	+/-0.040mm
最小レジストブリッジ幅	0.075mm	0.05mm	0.05mm
最小BGA Pitch	0.65mm	0.5mm	0.40mm
ルーター座繰り深さ精度	±0.10mm	±0.05mm	±0.05mm
最小コモンインピーダンス公差	+/-10%	+/-8%	+/-8%
最小差動インピーダンス公差	+/-10%	+/-8%	+/-8%
表面処理	半田レベラー(Pb有り/Pb無し), 金メッキ (無電解) , 錫メッキ (無電解) , 銀メッキ (無電解) , OSP, 金端子 (無電解) , ニッケルパラジウム		
基材	普通Tg, 中Tg, 高Tg, ハロゲンフリー, 高周波 (low Dk/Df) , 高スピート(ミドル/ロー/ヴェリィ/ウルトラ ロス), 高伝熱, 高CTEなど		

項目		2020	2021	2022
板厚		0.05~0.8mm	0.05~0.8mm	0.05~0.8mm
最小レーザー径		Ø0.05mm	Ø0.05mm	Ø0.035mm
最小ドリル径		Ø0.1mm	Ø0.1mm	Ø0.1mm
最大ドリル径		Ø6.3mm	Ø6.3mm	Ø6.3mm
最小L/S		0.045mm/0.045mm	0.045mm/0.045mm	0.035mm/0.035mm
片面/両面基板最小リング		0.1mm(Panel Plating) 0.125mm(Button Plating)	0.1mm(Panel Plating) 0.125mm(Button Plating)	0.1mm(Panel Plating) 0.1mm(Button Plating)
多層基板内層最小リング		0.125mm	0.125mm	0.1mm
多層基板外層最小リング		0.1mm(Panel Plating) 0.125mm(Button Plating)	0.1mm(Panel Plating) 0.125mm(Button Plating)	0.09mm(Panel Plating) 0.125mm(Button Plating)
カバー膜最小開口間隔		0.3mm	0.3mm	0.3mm
最小レジスト開口		0.3mm	0.3mm	0.25mm
最小コモンインピーダンス公差		±8%	±7%	±6%
最小差動インピーダンス公差		±8%	±7%	±7%
カバー膜最小開口		Ø0.5mm	Ø0.5mm	Ø0.5mm
		0.5mm*0.5mm	0.5mm*0.5mm	0.5mm*0.5mm
カバー膜位置 セット精度	人工位置合わせ	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
	治具	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最高層数	フレキ	6L	6L	8L
	分層板	6L	6L	6L
	リジットフレキ	8L	10L	12L
	リジットフレキHDI	8L	10L	12L
表面処理		金メッキ（電解）、金メッキ（無電解）、OSP、金メッキ（無電解）+OSP、金メッキ（電解）+OSP、金メッキ（電解）+金メッキ（無電解）		

項目	2020	2021	2022
最高層数	6L	8L	8L
最大デリバリパネル	500*740mm	500*740mm	500*740mm
金属ベース厚	0.5~4.0mm	0.5~4.0mm	0.5~4.0mm
最薄熱伝導層厚	0.038mm	0.038mm	0.038mm
最薄コア材厚	0.1mm	0.075mm	0.075mm
エッチング公差	±15% (L≥0.15mm)	±30um (@1oz)	±30um (@1oz)
	±20% (L < 0.15mm)	±40um (@2oz)	±40um (@2oz)
		±50um (@3oz)	±50um (@3oz)
		±15% (> 3oz)	±15% (> 3oz)
最小内層L/S	0.1mm/0.076mm	0.076mm/0.076mm	0.076mm/0.076mm
最小外層L/S	0.1mm/0.076mm	0.076mm/0.076mm	0.076mm/0.076mm
最小ドリル径	0.55mm (≥1/2 板厚)	0.55mm (≥1/2 板厚)	0.55mm (≥1/2 板厚)
	0.60mm (≥3/4 板厚)	0.60mm (≥3/4 板厚)	0.60mm (≥3/4 板厚)
ドリル穴公差	+ 0.05/-0mm	+ 0.05/-0mm	+ 0.05/-0mm
金型穴公差	+ 0.03/-0mm	+ 0.03/-0mm	+ 0.03/-0mm
最小皿穴径	0.6mm	0.6mm	0.6mm
	0.8mm	0.8mm	0.8mm
皿穴深さの公差	±0.05mm	±0.04mm	±0.03mm
レジストズレ公差	±0.04mm	±0.04mm	±0.04mm
耐高電圧	6KVAC	6KVAC	6KVAC
金属ベース種類	アルミベース、銅ベース、ステンレスベース、鉄ベース		
熱伝導率	D5470: 1-3W/m.K	D5470: 1-3W/m.K	D5470: 1-3W/m.K
	T0220: 1-8W/m.K	T0220: 1-12W/m.K	T0220: 1-12W/m.K
表面処理	OSP、金メッキ、銀メッキ（無電解）、銀メッキ（電解）、錫メッキ、HASL		

技術能力	2021	2022	2023
最高層数	24	32	40
最大ワーキングパネル	24.5"*37.5" (620mmX950mm)	24.5"*37.5" (620mmX950mm)	24.5"*37.5" (620mmX950mm)
板厚	4.0mm	4.0mm	5.0mm
最小L/S (mil)	I/L: 2.5mil/2.5mil O/L: 4mil/4mil(POFV)	I/L: 2.5mil/2.5mil O/L: 3.5mil/4mil(POFV)	I/L: 2.0mil/2.0mil O/L: 3.5mil/3.5mil(POFV)
最小ドリル径(mil)	6mil	6mil	6mil
アスペクト比率	18:1	20:1	22:1
最薄コア板厚(mil)	2mil	2mil	1mil
プレス層間ズレ(mil)	5mil	5mil	5mil
インピーダンス公差	+/-8%	+/-7%	+/-5%
裏スタブ開け	2-10mil	2-10mil	2-8mil
POFV	Yes	Yes	Yes
Skip-via(L1-3)	No	Yes	Yes
N+N	Yes	Yes	Yes
銅ブロック埋め込み	Yes	Yes	Yes
キャパシタ埋め込み	No	Yes	Yes
ハイスピード材 (低ロス材)	ミッドロス: TU862HF,IT-170GRA1,EM828G,M2,S7040G; ローロス: M4/M4S, S7439, TU872SLK, IT958G, NPG-170D, TU863+, I-speed, EM888S; 非常に低ロス: M6, IT968,TU883, Synamic 6, EM891, EM528,Meteorwave1000/2000,I-Tera ; 超低ロス: M7, TU933+, Synamic 6N,EM890K,Meteorwave3000/4000,Tachyon100G		
高周波数材	セラミック: RO4350B,S7136H,RO4730G3,Aerowave300 PTFE: TC350,RO3003,TLX		

技術能力	2021	2022	2023
最高層数	24	28	32
HDI 層構成	3+N+3	3+N+3	3+N+3
最大ワーキングパネル	24.5"*28.5" (620X720mm)	24.5"*28.5" (620X720mm)	24.5"*28.5" (620X720mm)
最小L/S (mil)	I/L: 2.5mil/2.5mil O/L: 4mil/4mil(POFV)	I/L: 2.5mil/2.5mil O/L: 3.5mil/4mil(POFV)	I/L: 2.0mil/2.0mil O/L: 3.5mil/3.5mil(POFV)
最大板厚	3.5mm	4.0mm	5.0mm
最小ドリル径(mil)	6mil	6mil	6mil
アスペクト比率	18:1	20:1	22:1
最小ビア及びアスペクト	4mil&0.8:1	4mil&1:1	3mil&1:1
最薄コア板厚(mil)	2mil	2mil	1mil
プレス層間ズレ(mil)	5mil	5mil	5mil
インピーダンス公差	+/-8%	+/-7%	+/-5%
裏スタブ開け	2-10mil	2-10mil	2-8mil
銅鍍金穴埋 (レーザー穴)	Yes	Yes	Yes
POFV	Yes	Yes	Yes
Skip-via(L1-3)	No	Yes	Yes
銅ブロックの埋め込み	Yes	Yes	Yes
キャパシタの埋め込み	No	Yes	Yes
ハイスピード材 (低ロス材)	ミッドロス: TU862HF, IT-170GRA1, EM828G, S7040G; ローロス: M4S, S7439, IT958G, TU863+, EM888S; 非常に低ロス: M6, IT968, Synamic 6, EM891, EM528, Meteorwave1000/2000 ; 超低ロス: M7, TU933+, Synamic 6N, EM890K, Meteorwave3000/4000		



項目	技術能力	2021	2022	2023
構造	最大層数	14	14	14
	層構成	2+N+2 3+N+3 Any layer	2+N+2 3+N+3 Any layer	2+N+2 3+N+3 Any layer mSAP
	出荷サイズ	18"X24.5", 20"X24.5", 21.5"X24.5",		
板厚	最小コア厚	50μm	50μm	40μm
	PP 品番	1027	1027	1017
パターン	最小L/S (mil)	40μm/40μm	35μm/40μm	30μm/30μm
	銅厚	12μm	12μm	15μm
関連	ビア (穴径/Land)	65μm/140μm	60μm/120μm	50μm/110μm
レジスト	最小レジストダ ム	45μm	40μm	35μm
	レジスト位置精 度	20μm	15μm	15μm
CNC	CNC加工公差	±100μm	±75μm	±75μm
誘電率Dk		3.4	3.2	3.0
誘電正接Df		0.011	0.008	0.003
基材	EM-285, EM-370(5), S1150G, IT-150G, IT-168G, IT-170GRA1, EM-355 (D)			
	/		EM-390, E-78G, RA555, EM-526, EM528K, R5575	



江西スマート工場と珠海高欄港工場紹介



プロセス統合による品質、原価、効率の向上!



品質保証

- ・オンライン化学分析
- ・データ収集
- ・オンライン銅厚、板厚測定
- ・ロット番号トレーサビリティ
- ・AI倉庫



コスト削減

- ・水・電気量モニターシステム
- ・省エネルギーモニターシステム



効率アップ

- ・裁断一端面処理ーR角ー洗浄ーベーキング
- ・内層前処理ー塗布ー露光ーDESーブラウン処理ライン
- ・PP裁断ーPP重ねー固定ーレイアップー積層プレスー取り外し
- ・無人配送物流(AGV搬送)



1
先入先出管理

2
動態棚卸し管理、24時間フル倉庫在庫状況の監視

3
EBSシステムとスマートデータリンク

ディープラーニングによる蓄積で貨物倉庫管理のスマート化が実現。データ入力の手数と正確性による材料の先入れ先出し、及び原材料の品質を保証。



薬水に対してSPC分析



薬水が自動追加



オンラインに薬水分析

Kinwong注目

オンライン薬液分析、自動的に追加量を計測し薬液を追加、パラメータ調整可能。

🕒 ロット管理とトレサビリティ

1 製造前に識別番号を読み込み

各基板のLOTにより区別を置く

2 製造中にCCDで識別番号を読み込み

水平線の生産工程にすべてCCDで基板上の識別番号を読み込んで、生産条件を調整

3 梱包前に識別番号を読み込み

製品LOT、D/Cなど情報で基板区別して梱包

製造中と梱包前にすべてCCDで識別番号を読み込まれるシステムで、全工程のLot管理、他基板とD/Cを混ぜられないように、コントロールできる。

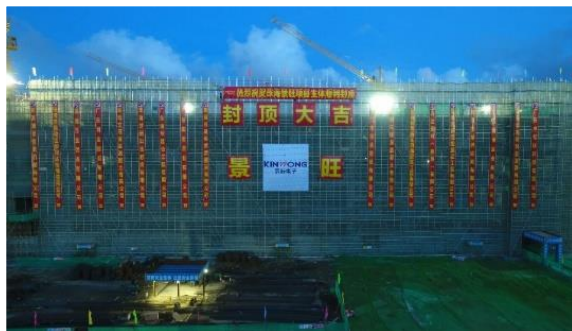


1
要求に応じて柔軟に経路を調整

2
注文を合理的に配分

3
人手運搬を減らすことで傷を削減

原材料/半製品/完成品など、前工程から次工程までの運搬、最後倉庫までの運搬動作が大幅に削減でき、傷などを減らす。



HLC事業部

工場キャパ企画10万m²/月

設備装置
全行程試作テスト 2021年1月

キャパアップ

2021.4	2021.12	2022.6	2022.12
2万m ² /月	5万m ² /月	7万m ² /月	10万m ² /月

SLP 事業部

工場キャパ企画5万m²/月

設備装置
全行程試作テスト 2021年5月

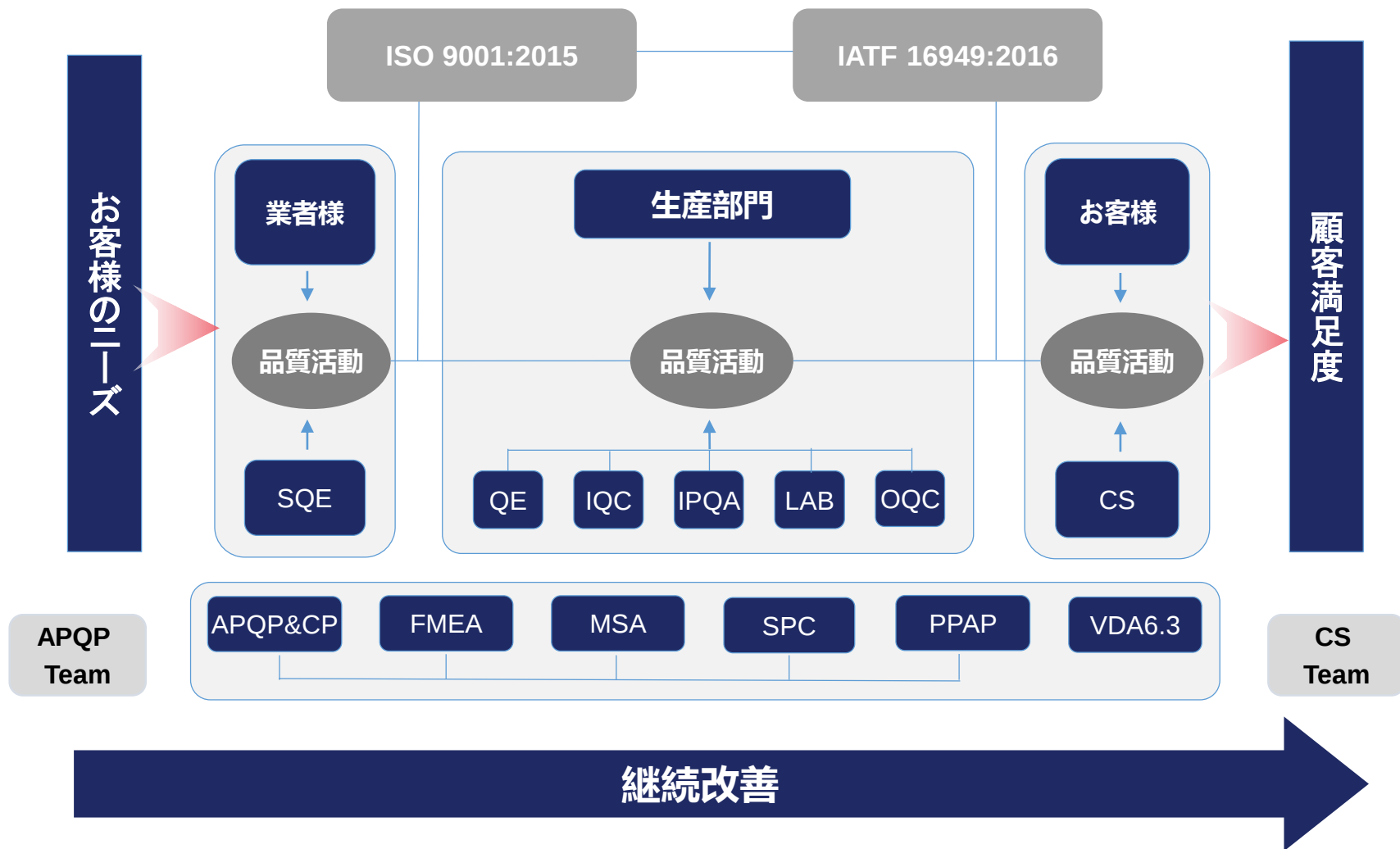
キャパアップ

2021.6	2022.3	2022.9	2023.9
1万m ² /月	2万m ² /月	3.6万m ² /月	5万m ² /月

備考：珠海高欄港基地HLC/SLP工場の建物は2020年7月11日に完成。



品質システム及び測定設備



Kinwong電子システム管理

質量システム QMS

通用
General
ISO9001



車載
Automotive
IATF16949



医療
Medical
ISO13485



企業社会責任 CSR

環境管理
Environment
ISO14001



職業の健康と安全
OHS system
ISO45001



エネルギー管理
Energy system
ISO50001



有害物質管理
HSPM
IECQ QC080000



情報安全システム ISMS

ISMS
ISO27001



他の管理システム Other systems

CNAS
IEC/ISO17025



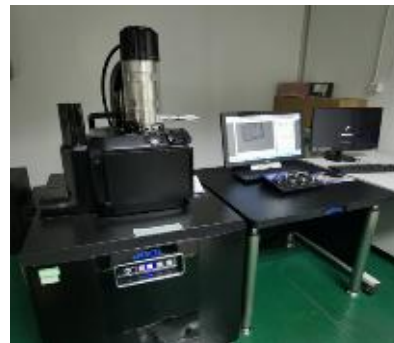
Plant	ISO9001: 2015 Quality	IATF16949: 2016 /TS16949 Automotive	ISO13485: 2016 Medical	ISO27001: 2013 ISMS	IECQ QC080000: 2017 HSPM	ISO14001: 2015 EMS	ISO45001: 2018	GB/T23331- 2012 Energy	GB/T23001- 2017 I&I	ISO/IEC17025: 2017 CNAS
深圳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
初回取得履 歴	2006-5-18	2006-4-20	2015-11-2	2019-12-25	2016-1-5	2008-12-24	2009-10-16	2018-12-20	2019-1-8	2017-1-3
龍川	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
初回取得履 歴	2008-7-6	2008-7-6	2019-5-22	2019-12-25	2014-3-11	2008-7-14	2013-4-22			
江西	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
初回取得履 歴	2014-9-8	2015-6-8	2018-11-1	2019-12-25	2015-7-14	2014-8-29	2016-1-4			
珠海富山	✓	✓			✓	✓				
初回取得履 歴	2017-9-14	2017-9-14			2016-5-27	2019-6-29				



CAFテストシステム



Online熱衝撃試験



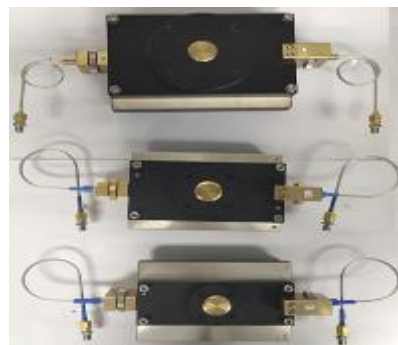
電子スキャナー顕微鏡 (SEM) +EDS



共焦点レーザー顕微鏡



ベクトルネットワークアナライザー
+ Dk & Dfテストシステム



ダイナミックメカニカル
アナライザー (DMA)



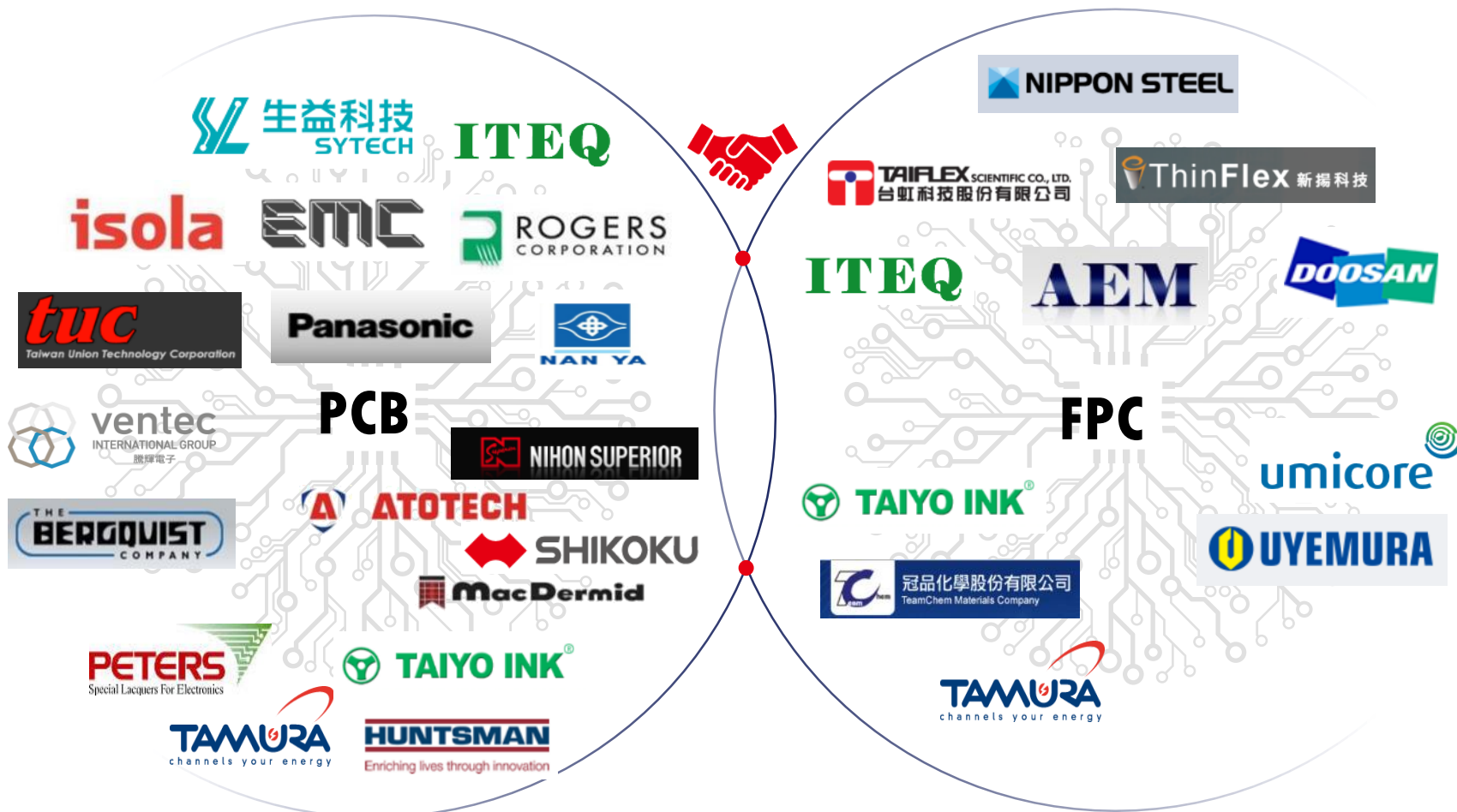
熱メカニカル
アナライザー



パートナー及び表彰



- 2020 ● ファーウェイ ハイシリコン
FPC最優秀サプライヤー 品質保証賞
- 2019~2015 ● Hella 最優秀サプライヤー賞
- 2019~2018 ● SUNGROW 優秀品質賞
- 2019 ● Plexus 最優秀パートナー賞
- 2018 ● Logitech 環境、ヒューマニズム賞
- 2018 ● HiRain 最優秀サプライヤー賞
- 2018 ● Artesyn最優秀サプライヤー賞
- 2018~2014 ● Honeywell 最優秀サプライヤー賞
- 2018 ● TIANMA 最優秀品質賞
- 2017 ● Huawei 最優秀品質賞
- 2017&2015 ● IMI 最優秀サプライヤー賞
- 2017 ● VIVO 最優秀品質賞
- 2017 ● DSBJ 最優秀サプライヤー賞
- 2017 ● 0-film 最優秀サービス賞





- 環境に関する法令・規制の遵守
- 省エネルギー・リサイクルの推進
- 清潔・安全で生産
- 継続改善でグリーン環境を構築する



- 地球環境の保護
- 人類社会
- 持続可能な発展に貢献する



景旺の経営理念は社員を基本とする、精品を製造する、業務を開拓する、社会を報うことです。



景旺は企業を拡大すると共に、積極的に献身的な社会活動（助学寄付、橋・道を建築する、困難に援助の手を伸びさす、老人を尊敬し、子供を愛する、ボランティア活動）を通して企業の社会的責任を果たしています。





THANKS

世界で最も信頼されるプリント配線板メーカーを目指す